

深圳市江波龙电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 3 月 25 日（周二）下午 15:00~16:30
地点	价值在线（ https://eseb.cn/1mJXrZTbus8 ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 蔡华波 独立董事 陈伟岳 副总经理、财务负责人 朱宇 副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2025 年 3 月 25 日，公司在价值在线平台举行了 2024 年度业绩说明会。公司高管对报告期内业绩情况进行了分析，并与参会的投资者进行了互动交流，详细情况如下：</p> <p>1、如何看待公司的增长潜力？</p> <p>答：目前，存储器厂商面临的发展瓶颈主要在于中低端市场的同质化竞争。但在 UFS4.1、车规级存储、企业级存储等高端市场中，独立存储器厂商的市占率仍然较低，因此公司在高端存储领域仍具有广阔的增长机遇。</p>

公司多年前已开始布局自研主控芯片、企业级存储等高技术难度领域，高起点组建研发人才队伍，持续进行长期研发投入。目前，公司已推出了用于 eMMC、SD 卡、车规级 USB 产品的三款主控芯片，至今累计应用量已超过 3000 万颗。公司已成功流片了首批 UFS 自研主控芯片，搭载自研主控芯片的 UFS4.1 产品，其顺序读写性能达到了 4350MB/s 和 4200MB/s，随机读写性能达到了 630K IOPS 和 750K IOPS，均优于市场主流产品。依托该系列主控芯片的强劲性能，公司的 UFS 产品有望打入高端智能终端市场。

近年来，公司积极推进 TCM（技术合约制造）与 PTM（存储产品技术制造）等创新商业模式，充分发挥技术、制造和品牌优势，为各行业头部客户提供“一站式”和“全栈式”服务。基于领先的封测制造实力，公司旗下元成苏州已通过互联网、汽车等多个行业重要客户的认证与审厂。

在海外市场，公司通过对巴西头部存储厂商 SMART Brazil（现更名为 Zilia）的股权收购，进一步强化了海外市场的开拓。公司以 Zilia 业务资源为基础，发挥 Zilia 贴近海外客户、自研技术、综合存储产品和海外制造优势，并协同公司资源、技术、品牌、供应链能力，辐射全球市场，逐步扩大 Zilia 在全球产业链中的作用，实现公司海外业务规模的长期增长。

2、公司是如何在短时间内实现在自研主控、企业级等领域的快速突破的？

答：公司成立至今已 26 年，在存储器设计、固件算法开发等领域，凭借多年的经验积累，形成了强大的技术优势。基于公司向行业 and 高端存储领域发展的战略，公司高起点组建研发团队，截至 2024 年年末，公司研发团队人数

已超千人，覆盖了存储芯片设计、主控芯片设计、固件算法开发、测试分析等多个领域。长期的资源投入积累在近几年持续转化为经营成果，公司在企业级存储、车规级存储、主控芯片等领域取得多项突破，并构建起了差异化的产业竞争壁垒。

3、如何看待公司 UFS 新产品导入到高端客户的进度？

答：公司在 UFS 领域内拥有业内领先的技术能力，以及成熟的应用生态，公司 UFS 产品已规模化的应用在众多智能终端大客户的各类产品当中。基于目前终端产品的创新趋势，存储需求呈现出愈发明显的多元化与定制化趋势，公司基于 UFS 主控芯片所赋能的产品性能领先优势，以及在产品、技术、制造、品牌等环节的体系化竞争能力，能够在 eMMC 向 UFS 过渡的关键时期，持续保持自身在市场中的领先地位。

4、如何理解自研主控与自主封测对于存储器厂商的意义？

答：公司正积极推进从过往的价差模式向服务和价值模式的转型，在满足标准化存储产品需求的基础上，通过灵活的定制化服务，覆盖更广泛的行业和客户群体。公司将依托自研主控与自主封测等核心能力，通过研发定制、封装测试及生产制造等服务，高效地提供存储产品的一站式解决方案，提升存储产业链从研发到生产再到应用的整体效率和效益。最终，自研主控及自主封测产能将为公司提供差异化竞争，以及向高端市场拓展的能力。

5、如何理解国内存储器厂商市场份额的提升趋势？

答：近年来，智能手机、PC、可穿戴设备等消费电子产品的迭代升级，以及数据中心、云计算、自动驾驶、物联网等新兴技术的快速发展为半导体存储企业发展提供了

良好的契机。与此同时，下游产业创新迭代对于存储企业的产品、技术、封测制造和服务能力均提出了更高的要求。基于长期以来在技术、生产、品牌、海外布局等方面多维度的能力积累，公司能够较好的把握住半导体存储产业发展窗口，实现业务的持续增长。

6、公司自研主控芯片的使用情况，以及未来的应用趋势？

答：公司自研主控聚焦于满足高端产品领域的客户需求，公司应用于 eMMC、SD 卡、车规级 USB 产品的三款主控芯片累计应用量已超过 3000 万颗，公司也成功流片了首批 UFS 自研主控芯片，基于 UFS 主控芯片的强劲性能，公司 UFS 产品有望打入高端智能终端市场，2025 年全年的自研主控芯片出货规模有望实现放量增长。公司也将保持与第三方主控芯片厂商合作，综合独立主控芯片厂商技术优势，拓宽自身产品组合，提供更多样化的存储解决方案。

7、公司自研主控与自主封测能力将如何影响盈利能力？

答：公司将依托自研主控与自主封测能力，向行业 and 高端市场拓展，并基于 TCM 与 PTM 的模式创新，形成差异化的产品和服务能力，推动公司业务向价值化、高附加值方向发展，实现公司业务规模与盈利能力的长期持续提升。

8、如何看待 eSSD 和 RDIMM 的应用趋势？

答：计算和存储能力的提升是 AI 技术持续进步和广泛应用的硬件基础，而高性能计算芯片要充分发挥其性能优势，需要高性能的内存系统与之匹配。为满足高强度的数据处理需求，除 HBM 之外，AI 服务器对于传统高性能 DIMM 内存的容量与读取性能要求也明显提升，与此相应

的，DDR5 在 RDIMM 产品的渗透率大幅提升。同时，AI 服务器进行大模型训练时产生的数据相较传统服务器的中间数据极具保存价值，因此保存次数大幅度增加。在此情形下 eSSD 的高速度、低能耗优势决定其可以大面积取代 HDD，全球各大云服务提供商均开始大规模采购 eSSD。

公司是国内少数具备“eSSD+RDIMM”产品设计、组合以及规模供应能力的企业，公司 eSSD 与 RDIMM 产品已在互联网、运营商等领域的多个知名客户处完成了产品验证和批量出货，未来公司将通过与大客户的深度长期合作，实现企业级业务的持续高速增长。

9、如何理解主控与固件的关系？

答：公司建立自研主控能力并匹配自研固件算法的既有竞争力后，通过硬件和软件搭配，能够有效解决通用主控芯片的兼容性难题，高效地满足客户，特别是大客户的产品性能要求，并且在售后服务故障解决等领域以自有能力帮助客户快速解决问题，从而最终建立起主营业务的进入壁垒，增加大客户粘性。

10、TCM 模式下，公司担任怎样的角色？

答：传统的价差模式下，市场需求的非预期波动和供需信息的时效性差异，可能阻碍晶圆原厂及时调整生产计划，并导致供需的阶段性的错配，并直接影响产业链各环节的盈利能力。TCM 模式下，公司将充分利用自身市场地位和与存储价值链中的主要参与者的长期业务关系，担当可靠中间桥梁，简化晶圆原厂和关键下游客户之间的沟通和供需信息交流，帮助晶圆原厂及时洞察市场需求，为其创造可预见的收入增长机会，并为头部客户提供更稳定、更高效的存储产品供应。公司凭借对市场需求的深刻洞察，充分发挥公司内部能力缩短产品开发交付周期，更好地服务于核心大客户，从而促进公司业务规模的扩大和销售额

的增长。

11、对储存后续涨价持续性如何看待？公司的业务增长和毛利变化趋势？

答：展望 2025 年，云服务提供商对 AI 硬件的持续投资，将推动对高性能计算和存储硬件的需求，服务器领域的高速、大容量存储产品需求仍有望保持增长。随着 AI 大模型技术在智能终端本地化和定制化应用的加速，智能终端设备处理能力与数据存储需求显著提升，单机存储容量不断增长，同时，AI 大模型与智能终端设备结合愈发紧密，应用场景不断扩展和细化，推动智能终端市场的中长期存储需求持续增长。

根据公开报道，多家存储晶圆原厂已宣布产能调整计划，积极调控产能以适应市场需求变化。随着终端库存水位逐渐恢复正常，供需关系将逐步改善，价格回升趋势将在行业供需博弈中逐步建立，2025 年存储产业有望呈现出前低后高的格局。

12、如何展望手机对存储定制化的趋势？

答：基于目前消费级产品多元化、大容量、高性能、低功耗的趋势，公司在嵌入式领域继续深耕先进技术，依靠自研主控、自研固件、自主封测等优势能力，推出了 UFS4.1、eMMC Ultra、QLC eMMC、7.2mm×7.2mm 的超小尺寸 eMMC、0.6mm（max）超薄 ePOP4x 等新型产品，创新产品在读写性能、物理特性上相较于市场主流产品具备明显优势，为手机、智能穿戴市场提供了更丰富的存储选择，能够有效的满足智能终端市场多元化与定制化需求。

13、国内消费降级，企业进口业务或国内销售是否会受到影响？

答：数据规模的持续增长为半导体存储产业提供了长

	<p>期动能，公司将充分发挥自身在技术、产品、封测制造、品牌、全球化运营等方面的体系化竞争优势，向行业、高端、海外和品牌方向发展，通过提升业务整体价值量，实现业务规模与盈利能力的持续增长。</p> <p>14、公司对于改善现金流有何措施和具体方案？</p> <p>答：公司经营活动产生的现金流量净额变化，主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。公司与供应商建立良好的合作关系，将通过谈判优化付款条件以及运用多种金融工具和策略，比如资金池管理、长短期融资等方式来稳定公司的流动性和现金流情况。此外，公司还将加强内部审计和风险控制，确保应付款的准确性、及时性和完整性，维护公司现金流的稳定和偿债能力。</p> <p>15、2025 年一季度业绩，会不会因为近期存货价值上涨而大幅改善？</p> <p>答：公司一季度经营情况，请以定期报告等相关公告所披露的信息为准。</p> <p>16、请问主控芯片目前营收占比几成</p> <p>答：公司自研主控聚焦于满足高端产品领域的客户需求，目前仅为自用，公司应用于 eMMC、SD 卡、车规级 USB 产品的三款主控芯片累计应用量已超过 3000 万颗，公司也成功流片了首批 UFS 自研主控芯片，基于 UFS 主控芯片的强劲性能，公司的 UFS 存储器有望打入高端智能终端市场，2025 年全年的自研主控芯片出货规模有望实现放量增长。</p>
附件清单（如有）	无